

A会场 高可靠性电子制造技术与工艺创新研讨会日程

7月5日（星期三）		成都祥宇宾馆三楼（祥瑞厅）
	07:30-09:00	签到登记
	08:40-09:00	大会开幕式
A1	09:00-09:30	SMT 高可靠焊接浅析 任清川 副总工程师/副主任 四川九洲电器集团有限责任公司
A2	09:30-10:10	松下车载电子解决方案 刘 畅 高级技术推进主管 松下电器机电（中国）有限公司
A3	10:10-10:40	焊检合璧：高可靠性焊接检测&自动化成套解决方案 沈懿俊 市场总监 快克智能装备股份有限公司
	10:40-11:00	自助茶歇、参观展示
A4	11:00-11:30	国产化替代高可靠性锡膏在微电子装联领域的应用研究 李爱良 技术总监 中山翰华锡业有限公司
A5	11:30-12:00	中小批量、多品种及短、散料表面贴装的完美单机解决方案 张平忠 总经理-国营企业业务部 优而备智自动化设备（上海）有限公司
	12:00-13:20	自助午餐、参观展示
A6	13:25-13:50	X-Ray 检测技术介绍及在电子半导体工艺中应用 潘云林 大区总监 日联科技股份有限公司
A7	13:50-14:15	3D DFM 工艺设计仿真加速电子设计工艺数字化转型 蔡 强 高级业务总监 上海望友信息科技有限公司
A8	14:15-14:45	CCGA 封装器件装配工艺技术研究 吕德春 主任 中国工程物理研究院电子工程研究所
	14:45-14:55	自助茶歇、参观展示、互动答题
A9	14:55-15:25	基于 ATE 的测试图形优化 王雪梅 元器件测试工程师 高级工程师 中国航天时代第 771 研究所西安太乙电子有限公司
A10	15:25-15:55	时效管理方法在表面贴装设备维护保养中的研究与应用 熊械名 工程科长 四川长虹精密电子科技有限公司
A11	15:55-16:25	铜铝异材低温超声固相互连及其热可靠性研究 甘贵生 教授 重庆理工大学
A12	16:25-16:55	微封装和微组装的技术融合 龙绪明 教授 西南交通大学
A13	16:55-17:00	互动抽奖、会议结束